

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成30年2月15日(2018.2.15)

【公開番号】特開2017-224826(P2017-224826A)

【公開日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【年通号数】公開・登録公報2017-049

【出願番号】特願2017-125526(P2017-125526)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

B 23 K 26/53 (2014.01)

【F I】

H 01 L 21/78 X

H 01 L 21/78 B

B 23 K 26/53

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月28日(2017.12.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定角度ごとに回転して停止するインデックステーブル上のチャックに、レーザ改質領域が形成された基板をロードする工程と、

前記ロード後、前記基板を研削して前記レーザ改質領域を除去する工程と、

前記レーザ改質領域が除去された前記基板に残存する加工歪を除去する工程と、

を有する、抗折強度の高い薄型チップの形成方法。

【請求項2】

複数のチャックを有し、所定角度ごとに回転して停止するインデックステーブルを備え

前記インデックステーブルの停止位置には、前記複数のチャックに対応して、レーザ改質領域が形成された基板を前記チャックにロードするロード手段と、前記基板を研削して前記レーザ改質領域を除去するレーザ改質領域除去手段と、前記レーザ改質領域が除去された前記基板に残存する加工歪を除去する加工歪除去手段とが設けられる、

抗折強度の高い薄型チップの形成システム。